

Title (en)

Process for sealing cavities and/or interstices in printing plates fixed on cylinders.

Title (de)

Verfahren zum Verschliessen und/oder Abdichten von Öffnungen, Hohl- oder Zwischenräumen bei auf Formzylindern aufgetragenen Druckplatten.

Title (fr)

Procédé pour le bourrage ou le remplissage des ouvertures vides ou fissures dans les plaques d'impression fixées sur cylindres.

Publication

**EP 0316597 A2 19890524 (DE)**

Application

**EP 88117314 A 19881018**

Priority

DE 3736180 A 19871026

Abstract (en)

A process for sealing cavities or interstices which are formed on fixing printing plates to a cylinder. The process employs a pasty, light-curable sealing compound composed of at least one photopolymerisable, ethylenically unsaturated low-molecular-weight compound (a), at least one polymeric binder (b) which is compatible with the photopolymerisable low-molecular-weight compounds of the component (a), at least one photopolymerisation initiator (c) and at least one finely divided oxidic filler (d) which, when mixed with the components (a) to (c), yields mixtures which are transparent to long wave UV light. Said sealing compound is cured after being applied by exposure to light and can be finally processed mechanically.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verschließen und/oder Abdichten von Öffnungen, Hohl- oder Zwischenräumen, die beim Aufbringen von Druckplatten auf einen Formzylinder gebildet werden, mittels einer pastösen, lichterhärtbaren Dicht- bzw. Verschlussmasse aus mindestens einer photopolymerisierbaren, ethylenisch ungesättigten niedermolekularen Verbindung (a), mindestens einem polymeren Bindemittel (b), das mit den photopolymerisierbaren niedermolekularen Verbindungen der Komponente (a) verträglich ist, mindestens einem Photopolymerisationsinitiator (c), sowie mindestens einem feinteiligen oxidischen Füllstoff (d), der im Gemisch mit den Komponenten (a) bis (c) für langwelliges UV-Licht transparente Mischungen ergibt. Diese Dicht- bzw. Verschlussmasse wird nach ihrer Applikation durch Belichtung ausgehärtet und kann mechanisch nachbearbeitet werden.

IPC 1-7

**B41D 5/00; B41F 27/12; G03F 7/26**

IPC 8 full level

**B05D 3/06** (2006.01); **B41F 27/12** (2006.01); **B41N 6/00** (2006.01); **B41N 6/02** (2006.01); **C09K 3/10** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B41F 27/1293** (2013.01 - EP US); **B41N 6/02** (2013.01 - EP US); **Y10S 430/107** (2013.01 - EP US); **Y10S 430/109** (2013.01 - EP US)

Cited by

EP0850781A1; US5998098A

Designated contracting state (EPC)

BE CH DE ES FR GB IT LI NL

DOCDB simple family (publication)

**EP 0316597 A2 19890524; EP 0316597 A3 19900328; DE 3736180 A1 19890503; JP H01221288 A 19890904; US 4927740 A 19900522**

DOCDB simple family (application)

**EP 88117314 A 19881018; DE 3736180 A 19871026; JP 26836488 A 19881026; US 26262988 A 19881021**